

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. November 2004 (18.11.2004)

PCT

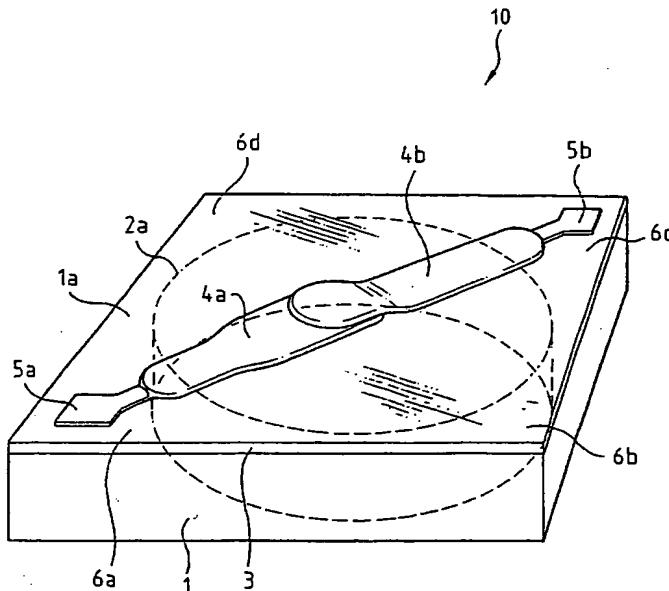
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/099063 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B81B 3/00**, H01L 35/02, 35/32, G01J 5/12
- (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HAUSNER, Martin** [DE/DE]; Sooderstrasse 63, 65193 Wiesbaden (DE). **SCHILZ, Jürgen** [DE/DE]; Am Schäfersberg 1 d, 65527 Niedernhausen (DE). **PLOTZ, Fred** [DE/DE]; Dietrich Bonhoeffer Strasse 14, 65232 Taunusstein (DE). **KARAGÖZOGLU, Hermann** [DE/DE]; Moabiter Strasse 3, 65205 Wiesbaden (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/004841
- (22) Internationales Anmeldedatum: 6. Mai 2004 (06.05.2004)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 103 20 357.5 7. Mai 2003 (07.05.2003) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **PERKINELMER OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG** [DE/DE]; Wenzel-Jaksch-Strasse 31, 65199 Wiesbaden (DE).
- (74) Anwalt: **BEETZ & PARTNER**; Steinsdorfstrasse 10, 80538 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: RADIATION SENSOR, WAFER, SENSOR MODULE, AND METHOD FOR THE PRODUCTION OF A RADIATION SENSOR .

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSSENSOR, WAFER, SENZORMODUL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES STRAHLUNGSSENSORS



(57) Abstract: Disclosed is a radiation sensor (10) comprising a support (1), a lowered area (2) that is embodied within a surface of the support (1) and can represent a depression or a through hole, a sensor element (4, 4a, 4b) which is embodied above the lowered area (2), preferably on a membrane (3) spanning the lowered area (2), and electrical contacts (5, 5a, 5b) for the sensor element (4, 4a, 4b). The lowered area (2) has an entirely or partly rounded contour (2a) within the surface of the support (1).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/099063 A2